

粉体工学会 2019 年第 1 回『ソフト粒子・界面研究会』（通算第 5 回）

2019 年第 1 回（2018 年度第 3 回）『ソフト粒子・界面研究会』を下記の内容で開催いたします。今回は、「アクティブマター」に関して精力的にご研究されている先生方を講師としてお迎えし、皆様とともに活発な討論の場にしたいと思っておりますので奮ってご参加ください。

参加ご希望の方は、誠にお手数ですが、下記の間合せ・連絡先へ 2019 年 1 月 16 日（水）までにメール等でご連絡をいただければ幸いです。

記

日 時： 2019 年 1 月 23 日（水）13:30～17:00

主 催： 粉体工学会「ソフト粒子・界面研究会」

共 催： 化学工学会 材料・界面部会

会 場： 同志社大学 大阪サテライト・キャンパス

（〒530-0001 大阪市北区梅田 1-12-17 梅田スクエアビルディング 17 階）

https://www.doshisha.ac.jp/information/campus/osaka_c/overview.html

JR「大阪」駅から徒歩 3 分

参加費： 無 料

◇プログラム◇

13:30～13:35 開会挨拶と趣旨説明

13:35～14:20 『アクティブマター工学の基礎と応用』

伴 貴彦 氏（大阪大学 基礎工学研究科）

14:20～15:05 『微粒子安定化ソフト分散体～刺激応答性アクティブソフトマテリアル～』

藤井 秀司 氏（大阪工業大学 工学部 応用化学科）

15:05～15:30 休憩

15:30～16:15 『遊泳微生物が見せる壁付近の運動』

市川 正敏 氏（京都大学 理学研究科）

16:15～17:00 『触媒反応によって自走する白金微粒子群の集団運動』

山本 大吾 氏（同志社大学 理工学部 化学システム創成工学科）

間合せ/連絡先：

〒610-0321 京都府京田辺市多々羅都谷 1-3

同志社大学 理工学部

山本 大吾

TEL：0774-65-6564（直通）

E-mail：dyamamot@mail.doshisha.ac.jp